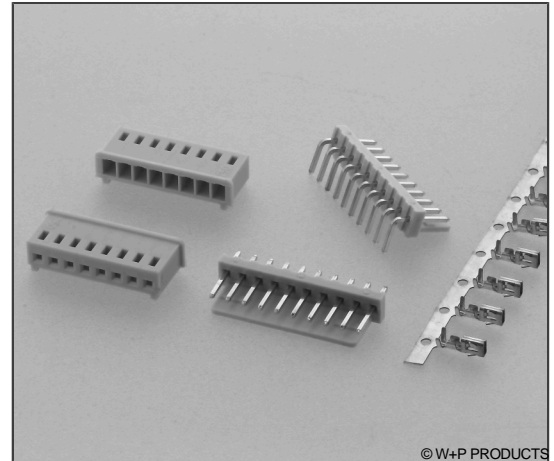


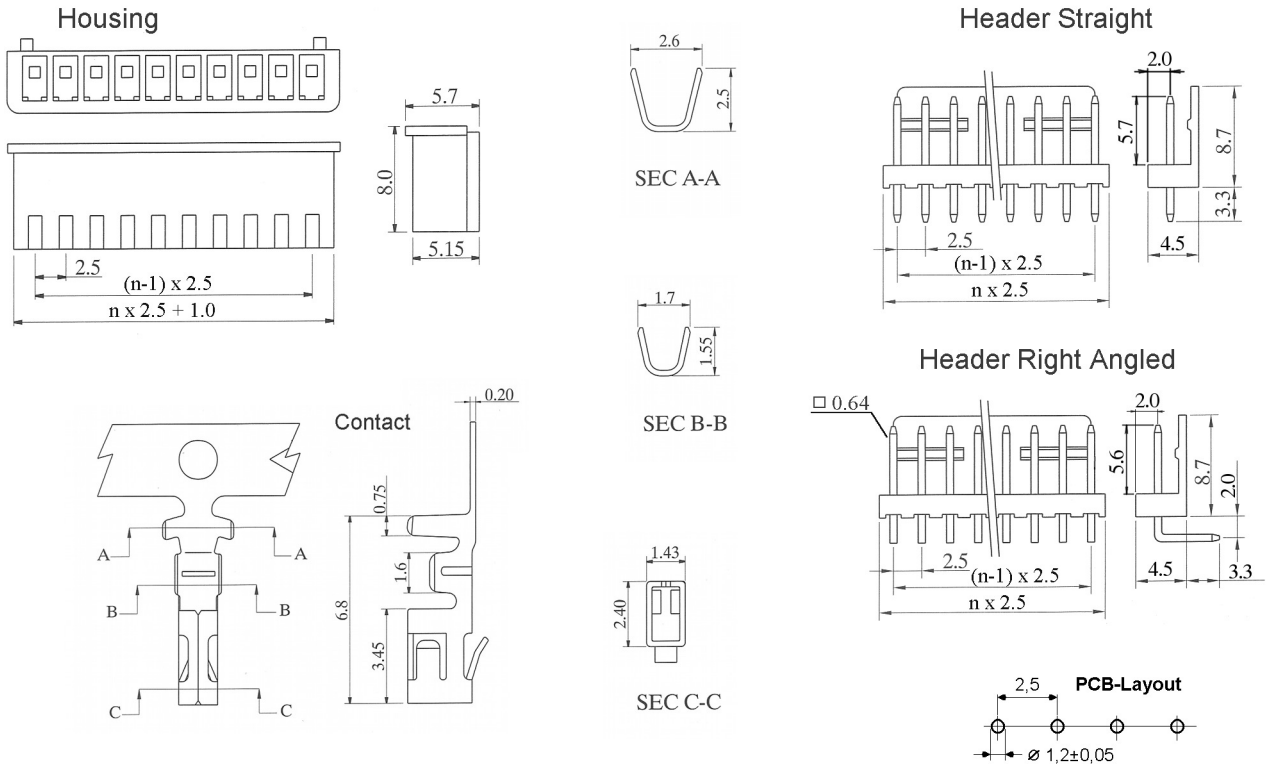
Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 2,50mm, gerade/gewinkelt Friction Lock Headers / Crimp Housings, 2.50mm Pitch, Straight/Right-Angled

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-2 (UL94 V-0 auf Anfrage) <i>Thermoplastic, rated UL94 V-2 (UL94 V-0 on request)</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,64mm, Kupferlegierung <i>Square pin 0.64mm, copper alloy</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 28 ~ 22
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	800 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	2 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25 °C ... +85 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellenlötverfahren <i>Wave soldering</i>



© W+P PRODUCTS



Series	Contacts*	Type*	Plating
576	08 02-20 01 (für Buchsenkontakte) (for crimp contacts)	3 1 Buchsengehäuse <i>Housing</i> 2 Buchsenkontakte <i>Crimp contacts</i> 3 Stiftleiste gerade <i>Straight pin header</i> 4 Stiftleiste gewinkelt <i>Right-angled pin header</i>	50 50 Verzinnt (für Gehäuse nicht erforderlich) <i>Tin plated (not necessary for housings)</i>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

